

PIANA KLEJĄCA PU



Właściwości

Piana klejąca PU to niskoprężny jednokomponentowy klej poliuretanowy w wersji z aplikatorem pistoletowym (posiada zawór uniwersalny także do aplikacji wężym). Wykazuje doskonałą przyczepność do podłoża betonowych, ceramicznych, drewnianych a także do PVC oraz wszelkiego rodzaju styropianów, tynków oraz podłoży z powłoką bitumiczną, papy i asfaltowych mas izolacyjnych. Po 2 godzinach od przyklejenia uzyskuje się utwardzenie wstępne pozwalające na kontynuację prac związanych z szlifowaniem i kołkowaniem płyt lub zabezpieczeniem przyziemi, a pełne utwardzenie spoiny poliuretanowej uzyskiwane jest po 24h.

Zastosowanie

JURGA PIANA KLEJĄCA PPU-2 służy do klejenia płyt styropianowych przy ocieplaniu ścian zewnętrznych budynków metodą BSO, kasetonów styropianowych, paneli ściennych, montażu parapetów, wypełniania szczelin w izolacji termicznej oraz w systemach ociepleń przyziemi (fundamentów) z użyciem płyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) oraz z zastosowaniem polistyrenu ekspandowanego (EPS).

Sposób użycia

Przygotowanie podłoża :

Podłoże powinno być czyste, suche, pozbawione kurzu, brudu, olejów, tłuszczów, resztek farb i innych zanieczyszczeń (w szczególności środków antyadhezyjnych), które mogą spowodować brak odpowiedniej przyczepności kleju do podłoża. Należy sprawdzić przyczepność istniejących powłok, tynków, warstw bitumicznych, a odspojone warstwy podłoży należy usunąć. Przed przystąpieniem do klejenia płyt styropianowych w niskich temperaturach z podłoża należy usunąć szron, a zacieki wodne osuszyć. W przypadku podłoży z powłoką bitumiczną (o nieznanymi parametrach) warto przeprowadzić próbę przyczepności tj. płytę z naniesionym klejem poliuretanowym przykleić do przygotowanego wcześniej fragmentu podłoża, a następnie po około minimum 2h wykonać próbę zerwania połączenia klejowego. Podłoże bitumiczne musi być wysezonowane, dobrze związane, wilgoć odparowana z całej grubości powłoki.

W systemach termoizolacji opartych na BSO przed przystąpieniem do klejenia płyt styropianowych należy zamocować listwy startowe, a w systemach izolacji fundamentów w celu uzyskania stabilnego podparcia dla klejonych płyt termoizolacyjnych,

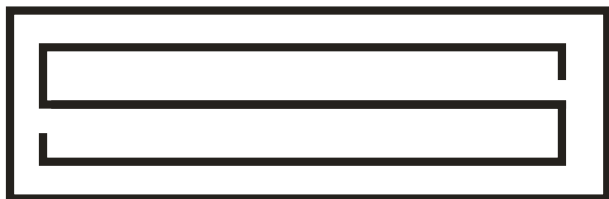
należy je wesprzeć na stopie fundamentowej, a jeśli to możliwe podeprzeć je w trakcie wiązania. Płyty izolacyjne hydrofobizowane przed klejeniem należy przeszlifować np. papierem ściernym.

Przed przystąpieniem do klejenia puszkę kleju należy ogrzać do temperatury pokojowej (dokonać można tego zanurzając puszkę np. w ciepłej wodzie), a następnie intensywnie wstrząsnąć puszką (przez ok. 30 sek.) w celu dokładnego wymieszania składników. Puskę przykręcić do pistoletu aplikacyjnego i dozować w pozycji roboczej „do góry dnem”. Regulację strumienia kleju dokonać poprzez ustawienie iglicy lub nacisk spustu pistoletu aplikacyjnego.

W przypadku przerwy w aplikacji powyżej 15 minut pistolet aplikacyjny należy zabezpieczyć, pozostawiając nakręconą puszkę do kolejnego użycia.

Klejenie płyt styropianowych w systemach opartych na BSO:

Klej do styropianu nakładamy warkoczem o średnicy ok 3 cm na płytę styropianowa po obwodzie z zachowaniem odstępu od jej krawędzi ok 2 cm i jednym pasem wzdłuż środka płyty. Należy zrobić około 5 cm przerwy w warkoczach jak przedstawiono na rysunku poniżej:



Po nałożeniu pasów kleju należy odczekać ok. 5 minut (temp. 20 °C), a następnie przyłożyć do izolowanej ściany i dokonać korekty położenia za pomocą łaty montażowej. Ustawienie klejonych płyt można dokonać do 10 minut od przyklejenia do izolowanej powierzchni. Po upływie 2 godzin płyty są gotowe do dalszej obróbki (szlifowanie i kołkowanie). Szczeliny i złącza pomiędzy klejonymi płytami wypełnić klejem. Po zakończeniu prac

pistolet aplikacyjny przeczyszczyć środkiem do czyszczenia np. czyścik do pian. Prac z użyciem kleju nie prowadzić podczas opadów atmosferycznych oraz silnego nasłonecznienia.

Klejenie płyt XPS w systemach ocieplania fundamentów:

Klej na płytę nakładamy 4 pionowymi warkoczami o średnicy ok 3 cm z zachowaniem równych odstępów co 20-30 cm pomiędzy pasami oraz pozostawić 3 cm odstępu od krawędzi płyty (w przypadku płyt o szerokości powyżej 100 cm, należy nałożyć na powierzchnię płyty większą ilość warkoczy kleju). Ogólny schemat postępowania przedstawiony został na rysunku poniżej:



Po nałożeniu pasów kleju należy odczekać ok. 5 minut (temp. 20 °C) lub 7-8 minut (temp. -5 °C), a następnie przyłożyć do izolowanej ściany i dokonać korekty położenia za pomocą łaty montażowej. Ustawienie klejonych płyt można dokonać do 10 minut od przyklejenia do izolowanej powierzchni. W narożnikach zastosować dodatkowo podpory do momentu związania kleju ok. 10-15 minut. Po upływie 2 godzin płyty są gotowe do dalszej obróbki. W strefie cokołowej oraz wzdłuż krawędzi budynku wymagane jest użycie dodatkowych mocowań mechanicznych. Szczeliny i złącza pomiędzy klejonymi płytami wypełnić klejem. Po zakończeniu prac pistolet aplikacyjny przeczyszczyć środkiem do czyszczenia np. czyścik do pian poliuretanowych. Prac z użyciem kleju nie prowadzić podczas opadów atmosferycznych oraz silnego nasłonecznienia. Nie stosować produktu w przypadku ciągłego narażenia na wodę np. przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnej lub wysokiego stanu wód gruntowych.

Przechowywanie

Produkt należy przechowywać w zamkniętym opakowaniu w pozycji pionowej, (aby zapobiec zaklejeniu zaworu) w dobrze wentylowanym pomieszczeniu w temperaturze od +5°C do +35°C (zalecana temperatura pokojowa) z dala od bezpośredniego nasłonecznienia oraz innych źródeł ciepła i zapłonu. Przechowywanie produktu w innych warunkach niż podane może spowodować skrócenie przydatności do użycia nawet o 3 miesiące.

Okres przydatności

12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na spodzie opakowania.

Informacje techniczne

Kolor	Jasno żółty
Temperatura pracy	Od -5°C do +30°C
Temperatura puszeki	Optymalnie +20°C
Czas korekty	Ok. 10 min (20°C, RH 90%)
Czas kołkowania	Ok. 2h
Czas pełnego utwardzenia	24 h
Czas cięcia	25 ± 10% minuty
Odporność termiczna (po utwardzeniu)	-50÷+90°C
Stabilność wymiarów	1 - 2% (przy 40 C , RH 95% , 24 h)
Nasiąkliwość wodą po 24h przy częściowym zanurzeniu	≤1kg/m ² PN-EN 1609:1999
Wytrzymałość	≥ 40 kPa (na ściskanie) PN-EN 12090:2013 ≥ 100 kPa (na rozciąganie) PN-EN 1607:2013
Przyczepność od podłoża z powłoką bitumiczną	≥ 150 kPa
Klasa palności	B3 wg normy DIN 4102
Rozpuszczalność preparatu w rozpuszczalnikach organicznych	aceton, przed utwardzeniem

Wydajność piany z opakowania 750ml	- klejenie XPS: do 12 m ² - klejenie BSO: do 8 m ² Wydajność jest uzależniona od temperatury i wilgotności powietrza.
W przypadku klejenia płyt styropianowych w systemie BSO	1 puszka piany przy aplikacji warkoczem o wymiarach średnicy 3 cm, wysokości 2,5 cm w podanym systemie wystarcza na ocieplenie do 8m ² powierzchni.
W przypadku klejenia płyt XPS w systemach ocieplenia przyziemi	1 puszka piany przy aplikacji warkoczem o wymiarach średnicy 3 cm, wysokości 2,5 cm w podanym systemie wystarcza na ocieplenie do 12m ² powierzchni.

Informacje specjalne

Preparat został zakwalifikowany jako stwarzający zagrożenie. Podczas pracy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej. Przed użyciem produktu należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki Materiałów Niebezpiecznych oraz ze szczegółowymi warunkami stosowania produktu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości przed rozpoczęciem pracy z produktem należy skontaktować się z działem doradztwa technicznego producenta. Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane. Prawidłowe, a co za tym idzie skuteczne stosowanie preparatu nie podlega naszej kontroli tak więc gwarancją objęta jest tylko jakość dostarczonego wyrobu. Producent ani jego upoważniony przedstawiciel nie może

ponosić odpowiedzialności za straty poniesione w skutek nieprawidłowego użycia lub przechowywania produktu. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszej karty wynikających np. ze zmian przepisów, modyfikacji wyrobu, postępu technicznego lub innych zaistniałych przyczyn Pracownicy Firmy Jurga upoważnieni są do przekazywania informacji technicznych tylko i wyłącznie zgodnych z niniejszą kartą techniczną. Informacje różniące się od informacji zawartych w niniejszej karcie winny być potwierdzone w formie pisemnej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć porady producenta. Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca i zastępuje wszystkie poprzednie.